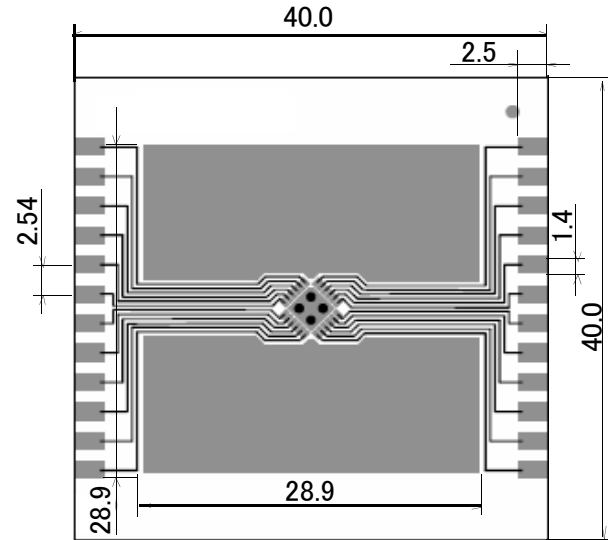


QFN0404-24Cパッケージ許容損失(105°C保証品)

QFN0404-24Cパッケージにおける許容損失特性例となります。
許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

- 測定条件：基板実装状態
雰囲気：自然対流
実装：Pbフリーはんだ
実装基板：銅箔4層基板40mm×40mm(片面1600mm²)
に対して銅箔面積
1層目：約50%_放熱板と接続無
2層目：約50%_放熱板と接続有
3層目：約50%_放熱板と接続有
4層目：約50%_放熱板と接続有
基板材質：ガラスエポキシ(FR-4)
板厚：1.0mm
スルーホール：ホール径 0.4mm 4個



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失 - 周囲温度特性

基板実装($T_{jmax} = 125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度(°C)	許容損失Pd(mW)	熱抵抗(°C/W)
25	1500	66.67
105	300	

